



GlobalWafers Co., Ltd.
環球晶圓股份有限公司

Global Family,
Global Solutions!

環球晶圓 (6488TT)

2025 年第二季營運報告

2025/08/05





Disclaimer

This presentation has been prepared by GlobalWafers Co., Ltd. (the “Company”). This presentation and the materials provided herewith do not constitute an offer to sell or issue or the solicitation of an offer to buy or acquire securities of the Company in any jurisdiction or an inducement to enter into investment activity, nor may it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Any decision to purchase securities in a proposed offering should be made solely on the basis of the information contained in the offering circular published in relation to such proposed offering, if any.

The information contained in this presentation has not been independently verified. No representation, warranty or undertaking, express or implied, is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness or correctness of the information or the opinions contained herein. The information contained in this document should be considered in the context of the circumstances prevailing at the time and has not been, and will not be, updated to reflect material developments which may occur after the date of the presentation. None of the Company nor any of its affiliates, advisors or representatives will be liable (in negligence or otherwise) for any loss howsoever arising from any use of this presentation or its contents or otherwise arising in connection with the presentation.

01

經營團隊重點報告



經營團隊重點報告

➤ 財務摘要

■ 營業收入

- ✓ 2025年第二季→ 新台幣160億元，季成長2.7%，歷年同期第三高！
- ✓ 2025年上半年→ 新台幣316億元，年增加3.9%，歷年同期第三高！

■ 營業毛利率

- ✓ 2025年第二季→ 25.8%
- ✓ 2025年上半年→ 26.1%

■ 營業淨利率

- ✓ 2025年第二季→ 15.2%
- ✓ 2025年上半年→ 15.9%



經營團隊重點報告

➤ 財務摘要

■ 稅後淨利率

- ✓ 2025年第二季→ 10.5%
- ✓ 2025年上半年→ 9.9%

■ 每股盈餘

- ✓ 2025年第二季→ 新台幣3.52元
- ✓ 2025年上半年→ 新台幣6.56元

■ 預收貨款

- ✓ 新台幣273億元 (美金9.3億元)¹

經營團隊重點報告

➤ 產業概況

■ 全球經濟

- ✓ 根據 OECD 預測，全球經濟成長率將由 2024 年的 3.4% 放緩至 2025 與 2026 年的 2.9%，主要受金融環境趨緊、貿易政策不確定性持續及企業信心下滑影響。
- ✓ 製造成本居高不下，通膨壓力恐加劇，進而抑制消費支出，並對半導體市場部分領域帶來下行風險。

■ 半導體市場

- ✓ 結構性成長穩固：人工智慧、機器人、醫療照護及再生能源等領域的長期需求依然強勁，將持續推動先進晶圓與材料的成長。環球晶圓憑藉全球整合、因地制宜的擴產策略，具備充分優勢把握這波成長循環。
- ✓ 庫存逐步正常化：下游庫存已趨於穩定並出現初步回溫跡象，但在總體經濟與貿易不確定性下，復甦速度可能仍然緩慢。
- ✓ 外部風險持續：地緣政治緊張、關稅措施（含報復性關稅及美國 232 調查）及匯率波動，仍對供應鏈造成壓力，並影響投資人信心。



經營團隊重點報告

➤ 產業概況

■ 環球晶圓的成長策略與財務健全狀況

- ✓ 環球晶圓美國與義大利的擴產據點已開始送樣，並藉由新增的 12 吋先進製程與 SOI 晶圓產能，強化區域布局。美國製造的產品正逐漸受到市場青睞，展現公司穩健的執行力與在日益增長的在地供應需求，預期將自 2025 年下半年至 2026 年上半年，逐步帶來營收貢獻。
- ✓ 既有廠區擴產計畫表現亮眼，日本廠與台灣廠出貨創新高，丹麥廠亦展現優異成果。憑藉遍及 9 個國家、18 座生產基地，以及以客戶為核心的供應鏈，環球晶圓具備競爭優勢，能靈活應對複雜的總體經濟與政策環境。



經營團隊重點報告

➤ 產業概況

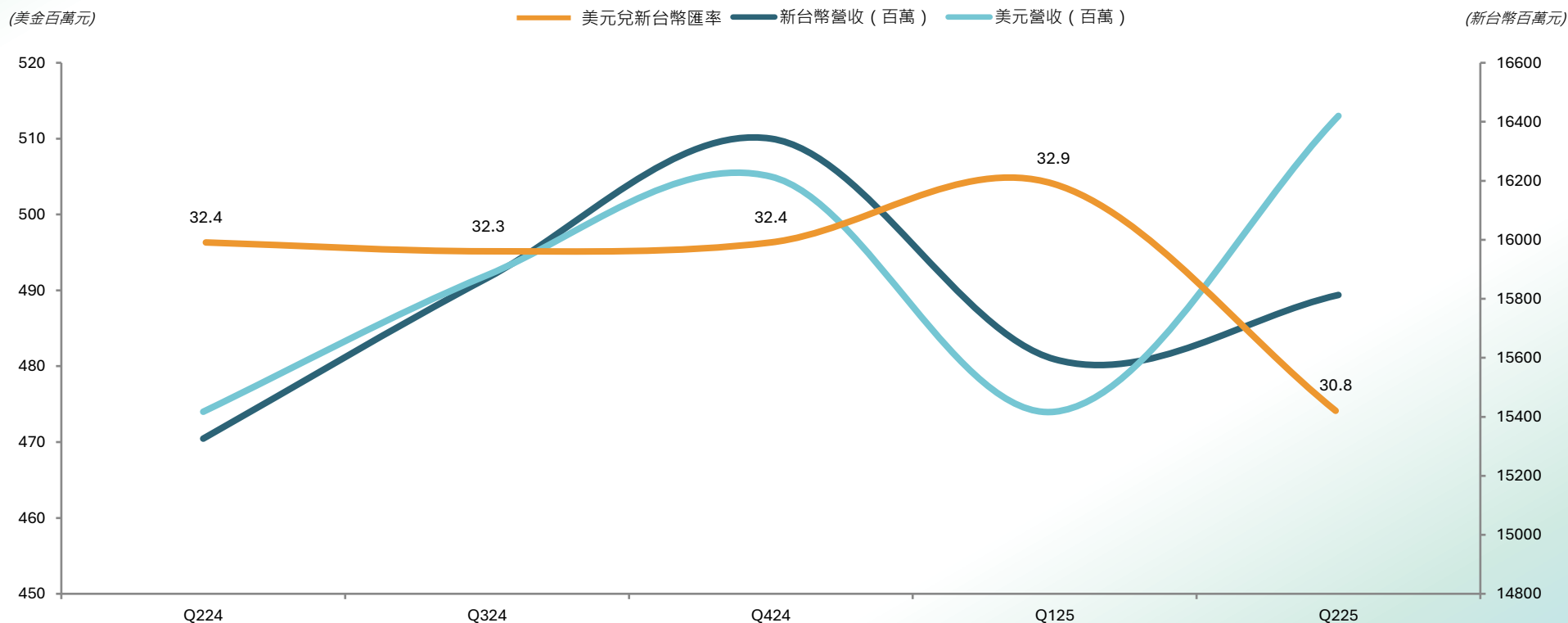
■ 環球晶圓的成長策略與財務健全狀況(續)

- ✓ 隨著氮化鎵 (GaN) 需求持續強勁，以及特殊晶圓產品的持續開發，我們正加速策略轉型，放大高附加價值的特殊晶圓 (如碳化矽、SOI、氮化鎵及FZ晶圓) 發展，並同步擴充12吋晶圓產能。當擴產計畫完成後，12吋晶圓預計將貢獻近三分之二的總營收，顯著提升獲利能力並鞏固技術領導地位。
- ✓ 在全球擴產持續推進的同時，我們的計息負債已降至新台幣 673.43 億元 (季減 6.4%)，同時流動比率及速動比率分別改善至 135% 與 113%。負債總額占資產總額比率為 58.9% (若僅計計息負債則為 32.6%)，凸顯我們穩健的資產負債表。我們預期，隨著補助挹注、營收逐步增長及全球佈局韌性發揮，將在不確定性持續的環境中迎來復甦。

新台幣升值影響環球晶圓營收

- 儘管新台幣升值帶來匯率逆風，環球晶圓的營收仍持續穩健成長，若以美元計價，成長趨勢更為明顯。公司透過避險措施及全球多元化的成本結構，並以當地貨幣進行支付，有效部分抵銷匯率風險。
- 以美元計算，環球晶圓第二季合併營收達5.2億美元，季增9.7%；2025年上半年合併營收達9.9億美元，年增4.2%。

新台幣營收與美元營收及匯率比較



02

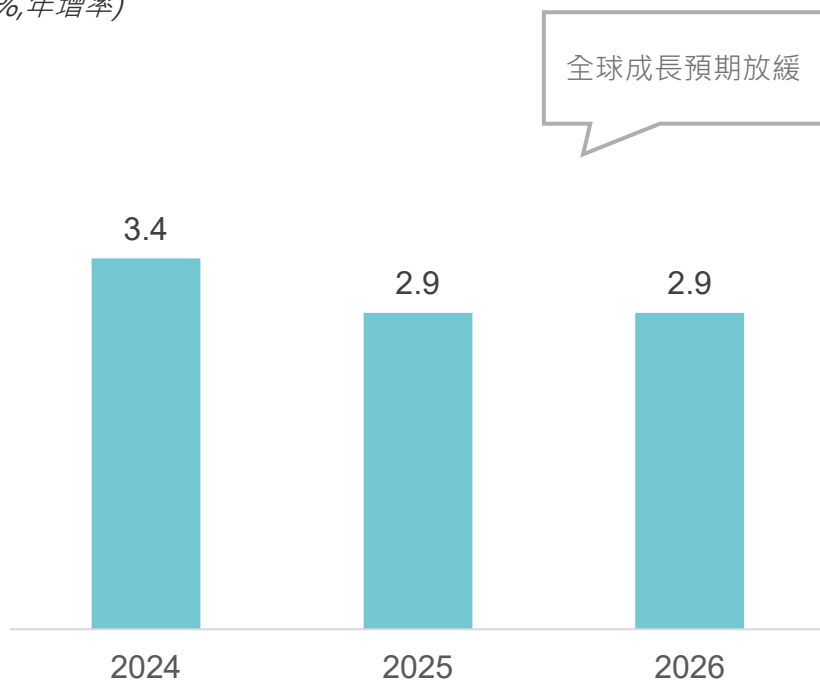
產業概況

全球展望因貿易政策不確定性而轉變

- 全球經濟前景正在轉弱，預期貿易障礙加劇、金融環境緊縮、信心下滑以及政策不確定性升高，將對成長帶來負面影響。
- 通膨水準可能會比預期維持更久，尤其在通膨預期持續上升的情況下。正面來看，若近期貿易障礙能提前解除，將有助於推升經濟成長並緩解通膨壓力。
- 預測全球GDP成長率將從2024年的3.4%放緩至2025與2026年的2.9%，而通膨仍將維持在高檔。

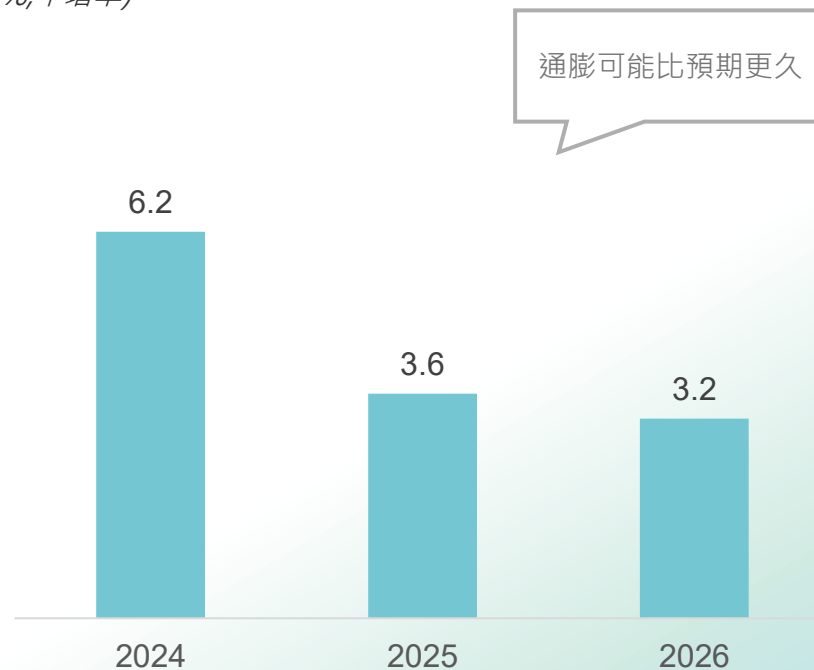
2024年實際GDP成長率及2025與2026年預測

(%,年增率)



2024年整體通膨率¹及2025與2026年預測

(%,年增率)



資料來源：經濟合作暨發展組織 (OECD) · 2025年6月

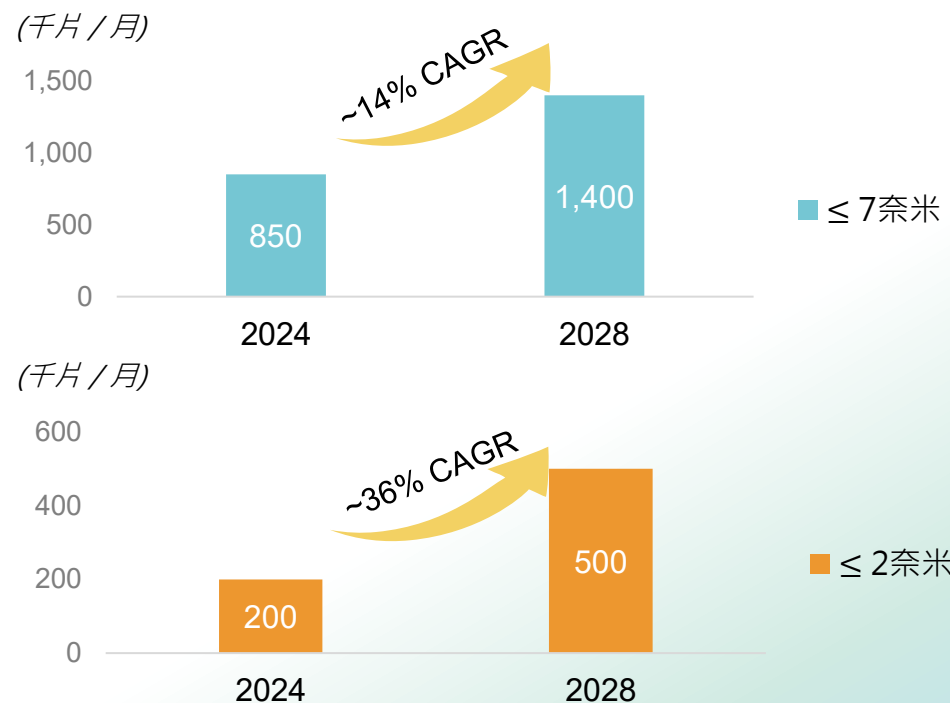
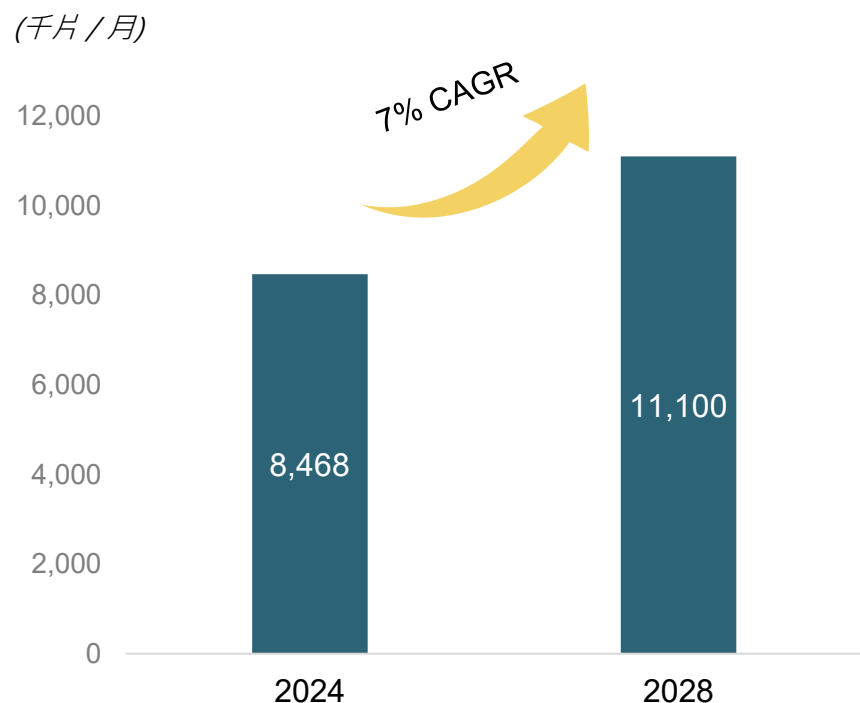
備註: 1. 整體通膨率 (Headline Inflation) 衡量消費者物價的整體變動，涵蓋所有類別，包括食品與能源



12吋晶圓廠與先進製程強勁成長 展望至2028年

- 自2025年至2028年，預計將有**59座新的12吋量產晶圓廠¹**投入營運，使總數在**2028年達到249座**。全球12吋晶圓產能預估將以**7%的年複合成長率**成長，至2028年達到每月1,110萬片。
- **主要成長動能來自先進製程產能（7奈米及以下）**，預計至2028年將從每月85萬片增加至140萬片，年複合成長率約14%。此外，由於AI需求強勁，**2奈米及以下的產能可能大幅增加**，預計至2028年將從低於每月20萬片提升至超過50萬片，年複合成長率約36%。

全球12吋晶圓產能



資料來源：SEMI，2025年6月

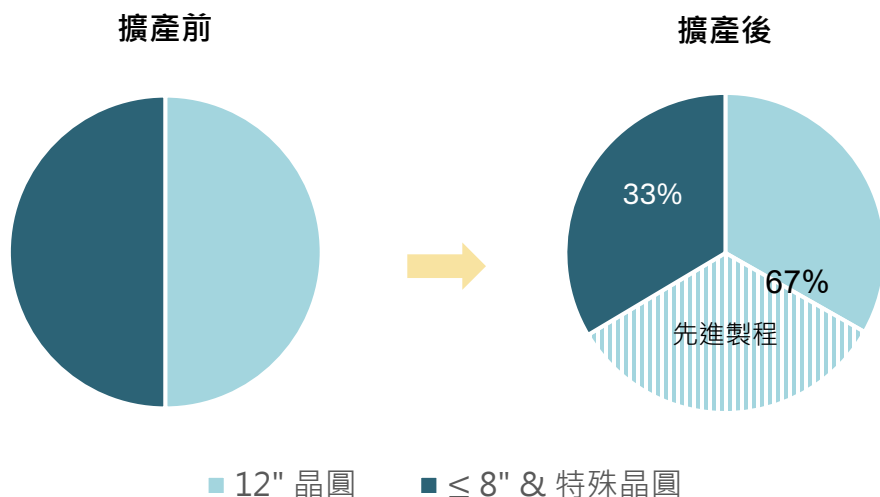
備註：1. 包含新建廠 (greenfield)、廠房 (shell)、量產晶圓廠，以及高可能性專案

2. 包含磊晶廠 (EPI fabs)


環球晶圓的成長動能：12吋晶圓與特殊晶圓

- 環球晶圓持續進行的12吋產能擴張，預期將使該產品線占比從約50%提升至近三分之二。同時，公司正策略性轉向高附加價值的特殊晶圓，例如SOI、碳化矽 (SiC)、氮化鎵 (GaN) 及FZ晶圓，這些產品具備更高利潤及技術門檻。此雙重布局將進一步提升獲利能力，並支持長期且永續的成長。
- 作為純晶圓供應商，環球晶圓維持與客戶不競爭的立場，同時在關鍵區域強化製造彈性。環球晶圓是全球前五大晶圓製造商中，唯一在歐洲、亞洲及美國皆具備先進特殊晶圓製程能力的業者，有助於推動以ESG為導向的的產能回流政策，確保在地化供應鏈，並降低地緣政治風險。

環球晶圓產品組合預估



環球晶圓競爭優勢

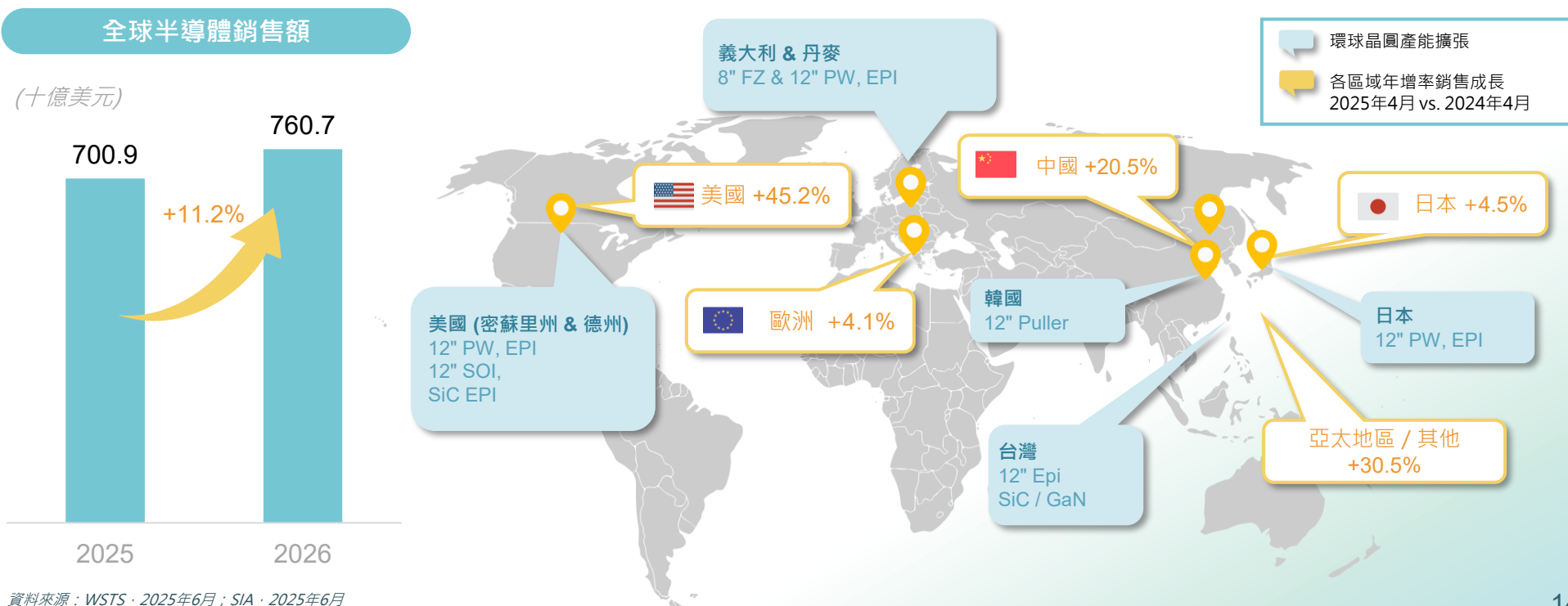
 以客戶為核心
純晶圓供應模式，避免通路衝突

 全球佈局
前五大供應商中唯一同時布局美國、歐洲與亞洲

 供應鏈韌性
強化ESG合規、營運靈活度及地緣政治風險承受能力

環球晶圓版圖與產業擴張趨勢契合

- 根據世界半導體貿易統計組織 (WSTS) 2025 年春季預測，全球半導體銷售額預計在 2025 年將年增 11.2%，達到 7,009 億美元，並在 2026 年成長至 7,607 億美元，主要成長動能來自邏輯與記憶體，受 AI、雲端基礎建設及先進消費性電子產品需求帶動。
- 從區域表現來看，2025 年 5 月的年增率，美洲成長 45.2%，亞太及其他地區成長 30.5%，中國成長 20.5%，日本成長 4.3%，歐洲成長 4.1%。
- 環球晶圓的擴產計畫與半導體產業結構性成長趨勢一致。憑藉其強大的全球佈局、貼近客戶的供應鏈設計、專注於在地採購，以及對綠色製造的承諾，環球晶圓在當前複雜的總體經濟與政策環境中，仍展現出韌性並準備迎接持續成長的機會。





產能擴張推動環球晶圓成長與韌性

- 位於美國（德州與密蘇里州）及義大利的策略性擴產計畫現已投入營運，專注於先進技術所需的高階晶圓。目前，小量出貨與客戶認證正在進行，預計將自2025年下半年至2026年上半年開始貢獻營收。
- 多個據點的現有廠區擴產計畫已全面進入量產，其中，日本與台灣的廠區已開始供應應用於先進製程的12吋磊晶晶圓。這些努力已開始挹注營收，並強化環球晶圓在高附加價值、技術密集型晶圓供應領域的實力。
- 憑藉遍布9個國家的18個生產據點，環球晶圓協助客戶實現供應鏈在地化，並更有效應對不斷變化的貿易環境，確保能更快速回應急單需求，同時提升營運韌性。

環球晶圓最新擴產進度

環球晶圓位於義大利的諾瓦拉工廠已完成首批 12 吋拋光晶圓出貨，並啟動客戶認證流程，目標於 2025 年底前達到量產



環球晶圓位於德州的 GWA 廠的產品已陸續送樣，標誌著美國擴產計畫的重要里程碑

環球晶圓位於密蘇里州的 MEMC LLC 已進入送樣階段，並擁有全美唯一的 12 吋先進 SOI 晶圓生產線



營收貢獻時程



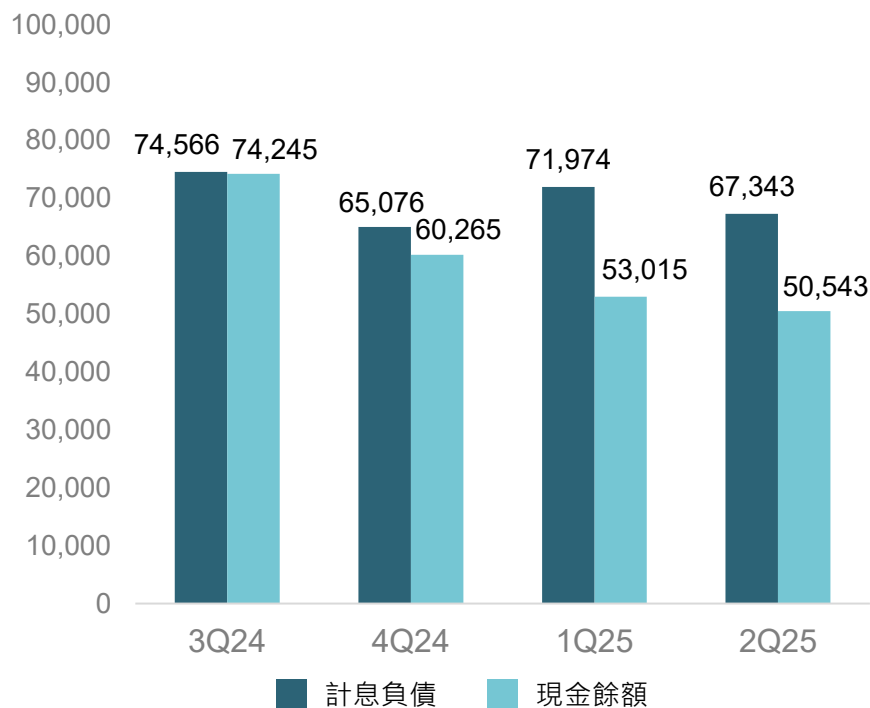
預計於2025年下半年至2026年上半年開始貢獻營收

資產負債表更趨穩健 槓桿水準健康

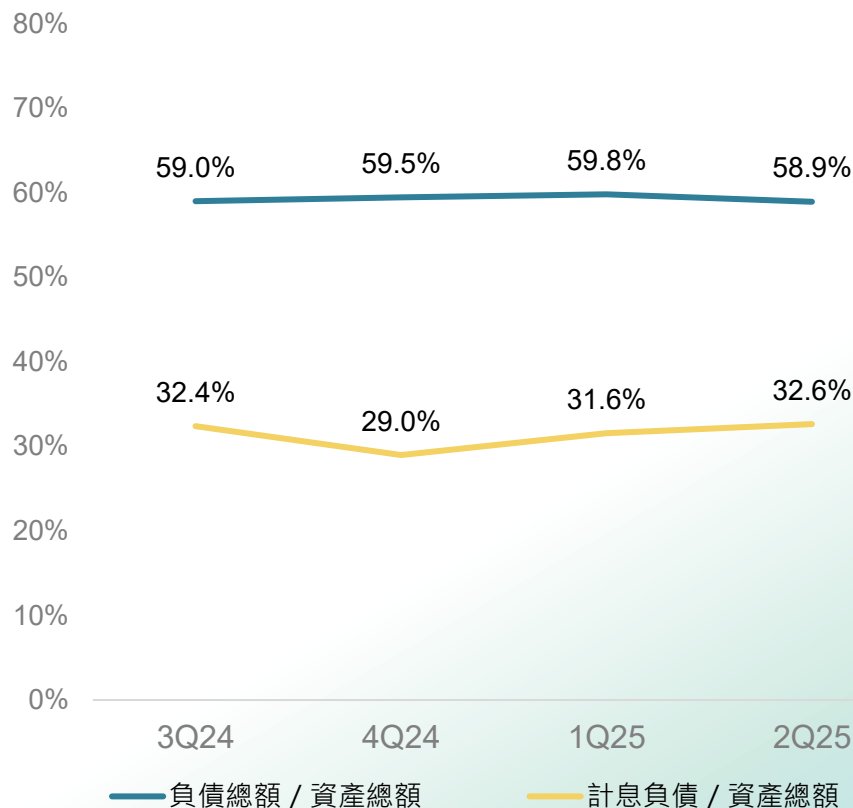
- 儘管持續投入先進製程擴產，環球晶圓的計息負債已降至新台幣 673.43 億元（季減 6.4%），現金水位則維持在新台幣 505.43 億元。
- 雖然2025年第二季負債總額占資產總額比率為58.9%，但計息負債¹僅占資產總額的32.6%，顯示公司資產負債表穩健，並持續致力於強化財務韌性。

現金與負債

(NT\$ Mn)



償債能力比率



備註: 1. 計息負債包含短期與長期借款及應付公司債

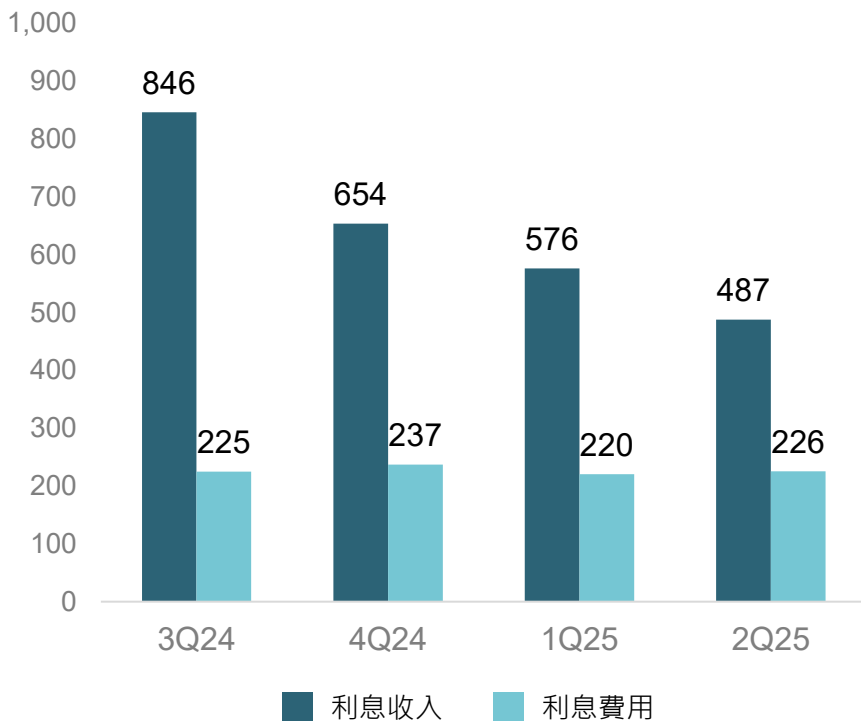
2. 現金餘額 = 現金及約當現金 + 銀行存款 (持有三個月以上) + 限制性現金 + 票據

流動性改善 財務體質韌性增強

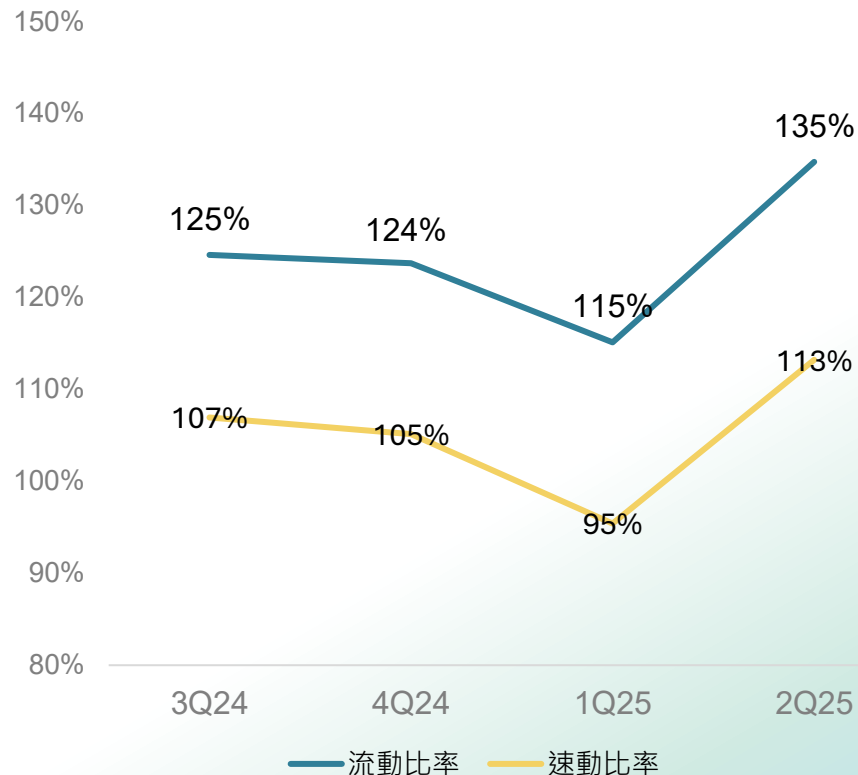
- 儘管資本支出持續進行，環球晶圓透過積極的財務操作優化現金，維持利息收入淨額。流動比率與速動比率分別提升至135%與113%，反映出更強的流動性與嚴謹的財務管理。
- 隨著補助款逐步到位及新產能於2025年下半年陸續開出，預期將進一步改善。

利息收入與利息費用

(NT\$ Mn)



流動性比率



備註: 1. 速動比率 = (流動資產 - 存貨 - 流動預付款項) / 流動負債

03

營運概況



財務摘要：2025年第二季 vs. 2025年第一季 vs. 2024年第二季

(單位: 新台幣百萬元, 除每股盈餘)	2025年第二季	2025年第一季	2024年第二季	季成長	年成長
營業收入	16,008	15,595	15,326	2.7%	4.5%
營業毛利 %	25.8%	26.4%	32.3%	-0.6ppt	-6.5ppts
營業淨利	2,438	2,589	3,367	-5.8%	-27.6%
營業淨利 %	15.2%	16.6%	22.0%	-1.4ppts	-6.8ppts
本期淨利	1,682	1,456	2,879	15.5%	-41.6%
本期淨利 %	10.5%	9.3%	18.8%	1.2ppts	-8.3ppts
每股盈餘 ¹	NT\$3.52	NT\$3.05	NT\$6.02	NT\$0.47	-NT\$2.50
EBITDA* ²	4,472	4,033	4,600	10.9%	-2.8%
EBITDA %	27.9%	25.9%	30.0%	2.0ppts	-2.1ppts
EBIT ³	2,027	1,778	2,614	14.0%	-22.5%
股東權益報酬率 /ROE* ⁴ (年化)	7.6%	6.4%	14.2%	1.2ppts	-6.6ppts
資產報酬率 /ROA* ⁵ (年化)	3.4%	2.8%	5.6%	0.6ppt	-2.2ppts
資本支出 ⁶	7,537	11,557	12,699	-	-
折舊費用	2,440	2,250	1,981	-	-

備註: 1. EPS = 歸屬於母公司淨利 / 期間內平均已發行普通股數量

2. EBITDA = 本期淨利 + 所得稅 + 利息 + 折舊費用 + 攤銷費用

3. EBIT = 本期淨利 + 所得稅 + 利息

4. ROE = 本期淨利 / 股東平均權益

5. ROA = ((本期淨利 + 利息費用 * (1 - 有效稅率)) / 平均資產

6. Capex = 期末取得不動產、廠房及設備及預付設備款 - 期初取得不動產、廠房及設備及預付設備款



財務摘要：2025年上半年 vs. 2024年上半年

(單位: 新台幣百萬元, 除每股盈餘)	2025年上半年	2024年上半年	年成長
營業收入	31,602	30,413	3.9%
營業毛利 %	26.1%	33.3%	-7.2ppts
營業淨利	5,027	7,334	-31.5%
營業淨利 %	15.9%	24.1%	-8.2ppts
本期淨利	3,138	6,412	-51.1%
本期淨利 %	9.9%	21.1%	-11.2ppts
每股盈餘 ¹	NT\$6.56	NT\$14.04	-NT\$7.48
EBITDA* ²	8,505	10,482	-18.9%
EBITDA %	26.9%	34.5%	-7.6ppts
EBIT ³	3,804	6,639	-42.7%
股東權益報酬率 /ROE* ⁴ (年化)	7.1%	16.3%	-9.2ppts
資產報酬率 /ROA* ⁵ (年化)	3.2%	6.4%	-3.2ppts
資本支出 ⁶	19,094	23,137	-
折舊費用	4,689	3,832	-

備註: 1. EPS = 歸屬於母公司淨利 / 期間內平均已發行普通股數量
 2. EBITDA = 本期淨利 + 所得稅 + 利息 + 折舊費用 + 攤銷費用
 3. EBIT = 本期淨利 + 所得稅 + 利息
 4. ROE = 本期淨利 / 股東平均權益
 5. ROA = ((本期淨利 + 利息費用 * (1 - 有效稅率)) / 平均資產
 6. Capex = 期末固定資產 - 期初固定資產

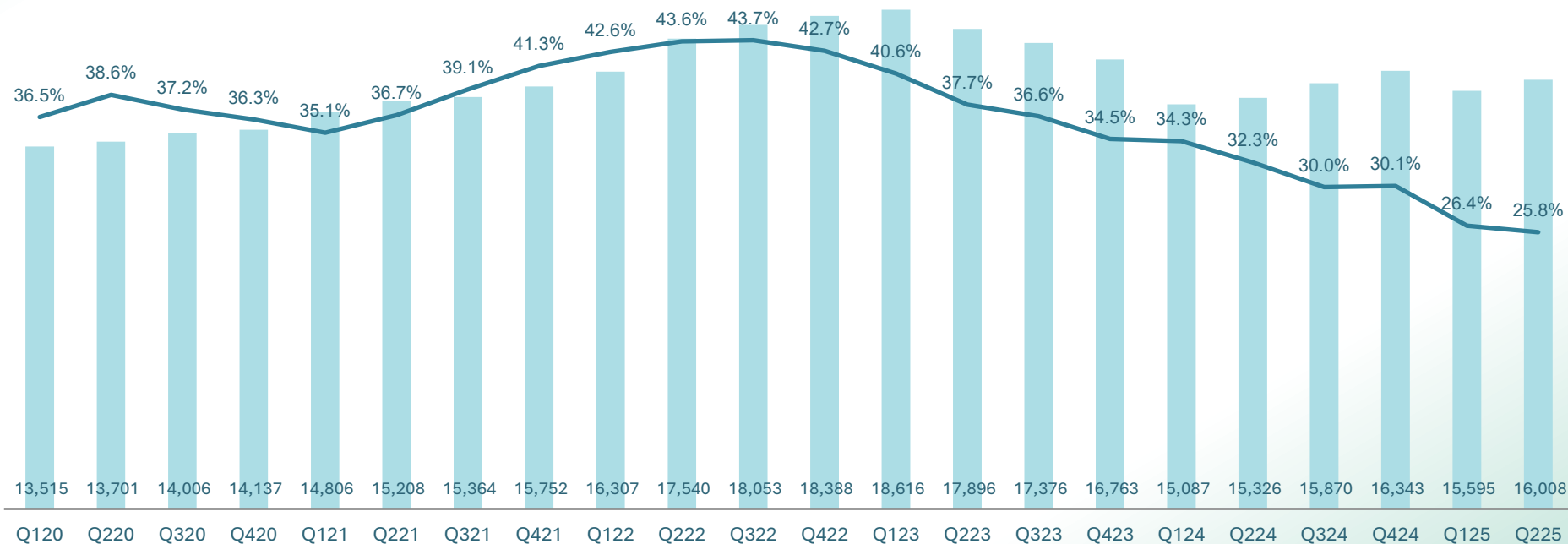


營業收入 & 營業毛利率(%)

營業收入 & 營業毛利率 (%)

(新台幣百萬元)

營業收入 營業毛利率 (%)



備註: 1. 2025年第二季毛利率季減，主要因為擴產導致折舊費用增加

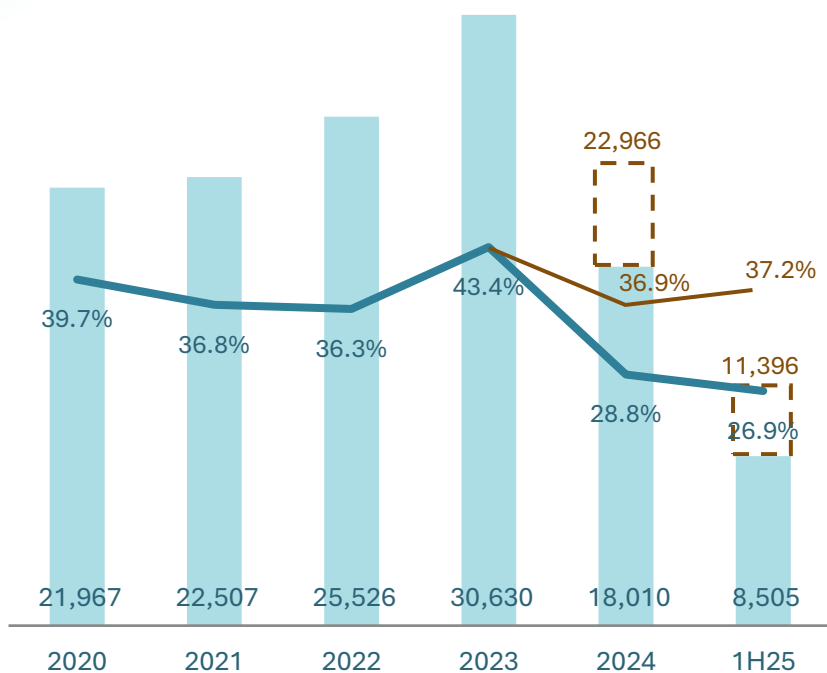


EBITDA & 每股盈餘

EBITDA

(新台幣百萬元) ■ EBITDA — EBITDA / 營業收入

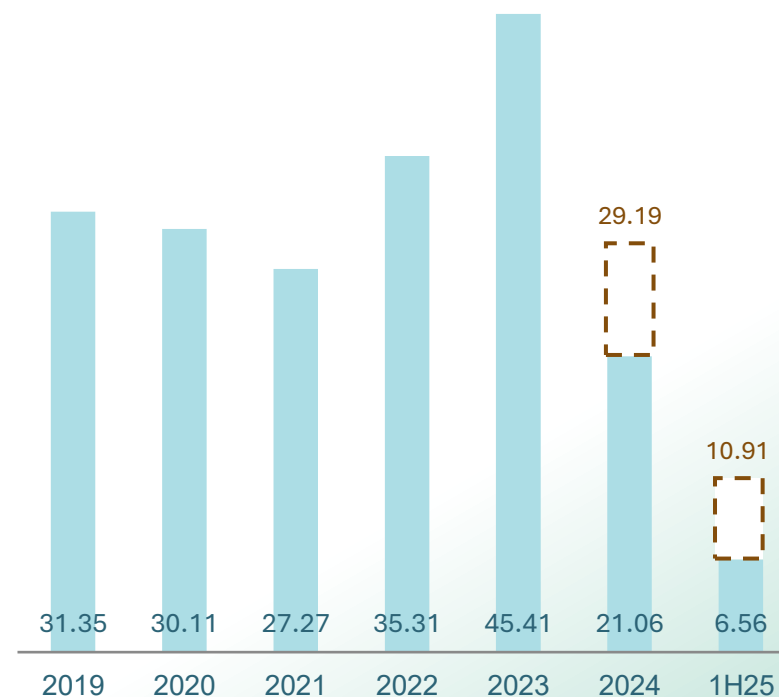
在排除持有 Siltronic 股份的市值評價變動影響，並假設未有重大擴產計畫的情況下，EBITDA 呈現成長趨勢



每股盈餘

(新台幣元)

在排除持有 Siltronic 股份的市值評價變動影響，並假設未有重大擴產計畫的情況下，每股盈餘呈現成長趨勢





損益表

新台幣百萬元	2024	Q125	Q225	1H25	1H25 (模擬) ¹
營業收入	62,626	15,595	16,008	31,602	30,663
成長率 (%)	-11.4%	3.4%	4.5%	3.9%	-
營業毛利	19,804	4,112	4,123	8,235	9,962
營業毛利率 (%)	31.6%	26.4%	25.8% ³	26.1%	32.5%
EBITDA	18,010	4,033	4,472	8,505	11,396
EBITDA率 (%)	28.8%	25.9%	27.9% ⁴	26.9%	37.2%
營業淨利	14,118	2,589	2,438	5,027	7,031
營業淨利率 (%)	22.5%	16.6%	15.2%	15.9%	22.9%
稅前淨利	12,429	2,133	2,289	4,422	7,313
稅前淨利率 (%)	19.8%	13.7%	14.3%	14.0%	23.8%
稅後淨利	9,839	1,456	1,682	3,138	5,216
稅後淨利率 (%)	15.7%	9.3%	10.5%	9.9%	17.0%
每股盈餘 (NT\$)	21.06	3.05	3.52	6.56	10.91

備註: 1. 模擬數係排除美國、義大利和日本的重大擴產計畫與持有 Siltronic 股份的市值變動影響

2. 成長率係指與去年同期相比的變動幅度 (YoY)

3. 2025 年第二季毛利率季減，主要原因為擴產導致折舊費用增加

4. 2025 年第二季 EBITDA 利潤率季增，主要原因為 Siltronic 股份市值變動帶來的評價收益



資產負債表

新台幣百萬元	2023	2024	Q125	Q225
資產				
現金及約當現金	26,165	38,929	28,846	22,220 ¹
應收帳款	10,116	10,265	10,845	10,140
存貨	9,359	11,238	11,953	10,303
不動產、廠房及設備	72,251	119,074	128,495	114,496 ²
其他資產	71,097	45,074	47,987	49,201
資產總計	188,988	224,581	228,126	206,361
負債				
短期借款	40,000	28,797	32,275	24,287 ¹
應付帳款	5,027	5,371	4,433	3,804
長期借款	14,542	37,648	39,699	43,055 ¹
其他負債	62,966	61,706	60,043	50,334 ³
負債總計	122,534	133,553	136,449	121,480
權益總計	66,454	91,028	91,677	84,881⁴

現金資產細項包含:	
(新台幣百萬元)	Q225
三個月以上定存	3,610
受限制現金	18,882
債券	5,831

備註: 1. 2025 年第二季現金及約當現金減少，部分原因為使用現金償還債務
 2. 短期借款減少且長期借款增加，主要因債務重組所致
 3. 2025 年第二季不動產、廠房及設備減少，原因包括補助款、折舊以及匯率換算影響
 4. 2025 年第二季其他負債減少，主要因預付款項減少及匯率波動影響
 5. 2025 年第二季股東權益減少，主要因匯率波動影響

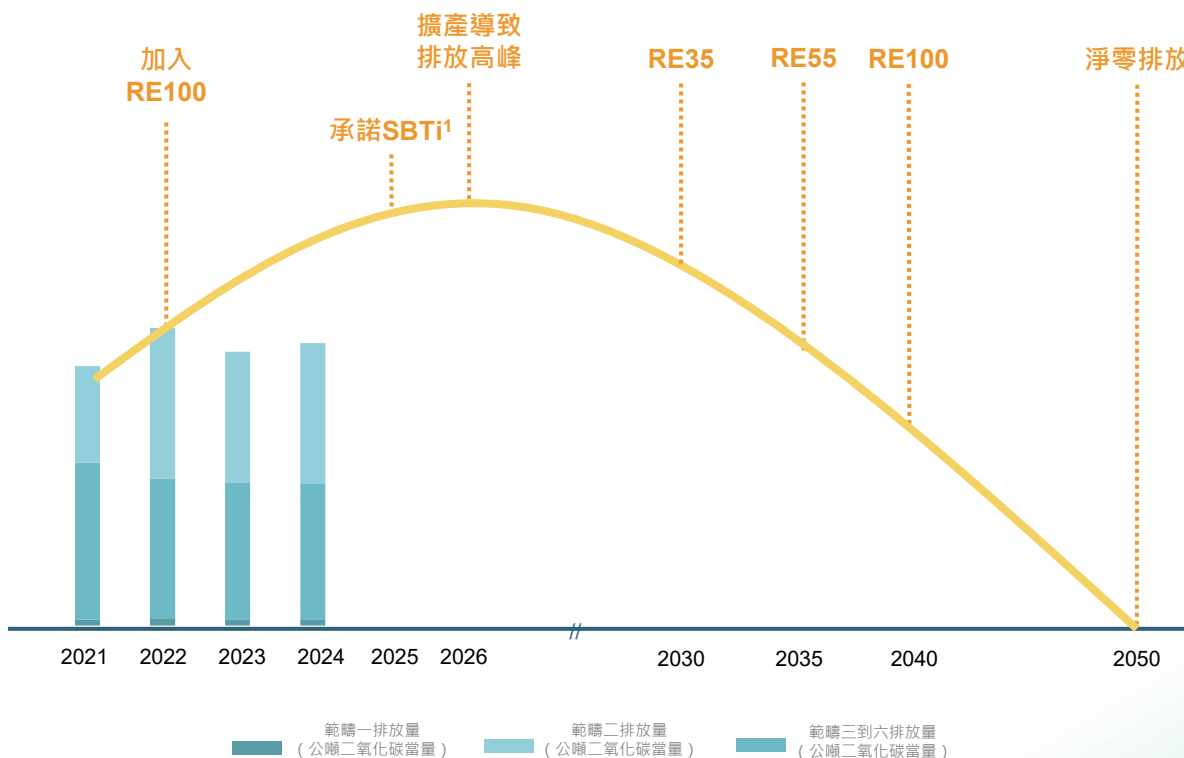
04

ESG

ESG 實施成果：環境保護 – RE100

- 環球晶圓已將 RE100 目標從 2050 年提前至 2040 年，致力於在所有據點實現 100% 再生能源使用，展現其對氣候行動的堅定承諾，並強化其作為半導體價值鏈中值得信賴的合作夥伴角色。
- 透過在全球各據點自建太陽能發動系統、簽署購電協議 (PPA)、購買再生能源憑證 (REC) 及採用再生能源等策略，環球晶圓積極打造低碳製造環境，降低碳排放、減少能源成本，並為產業創造更永續的未來。

環球晶圓溫室氣體 (GHG) 減量藍圖



備註: 1. 環球晶圓預計於 2025 年簽署科學基礎減量目標倡議 (SBTi) 承諾

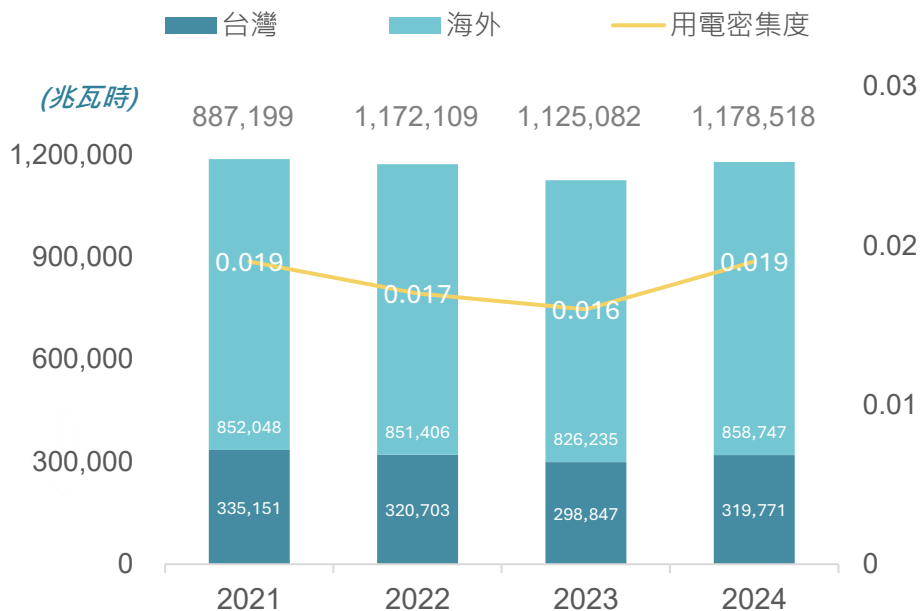
環球晶圓 RE 策略

-  採用再生能源
-  提升能源使用效率
-  購買碳補償商品
-  碳清除
-  價值鏈減碳

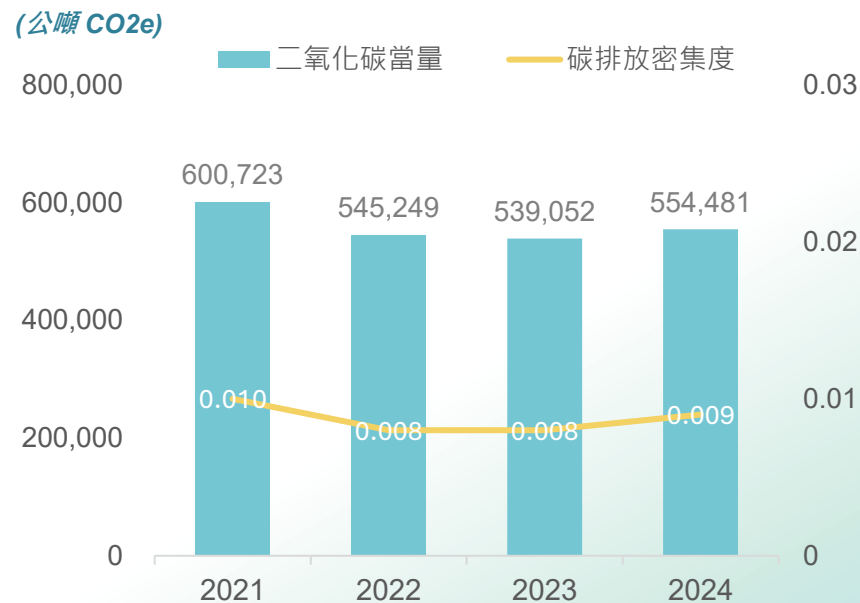
ESG 實施成果：環境保護 – 溫室氣體 & 用電量

- 環球晶圓所有主要生產據點皆已取得 ISO 14001 環境管理系統認證，顯示其對環境管理的承諾。同時，公司亦積極在全球據點推行 ISO 50001 能源管理系統。
- 2024 年，總用電量增加至 118 萬兆瓦時 (MWh)，其中超過 70% 來自海外據點。儘管環球晶圓持續擴大全球產能，但電力使用強度仍維持在每千新台幣營收 0.019 兆瓦時，反映出在擴產過程中有效的能源效率控制。
- 溫室氣體 (GHG) 總排放量(類別1&2)略增至 554,481 公噸二氧化碳當量 (tCO₂e)，主要受廠房擴建並正式啟用所影響。然而，碳排放強度仍穩定維持在每千新台幣營收 0.009 公噸二氧化碳當量，優於 2021 年的基準值 0.010，顯示公司在減碳進程上的持續進展。

用電量, 2021-2024



溫室氣體排放量(類別1&2), 2021-2024



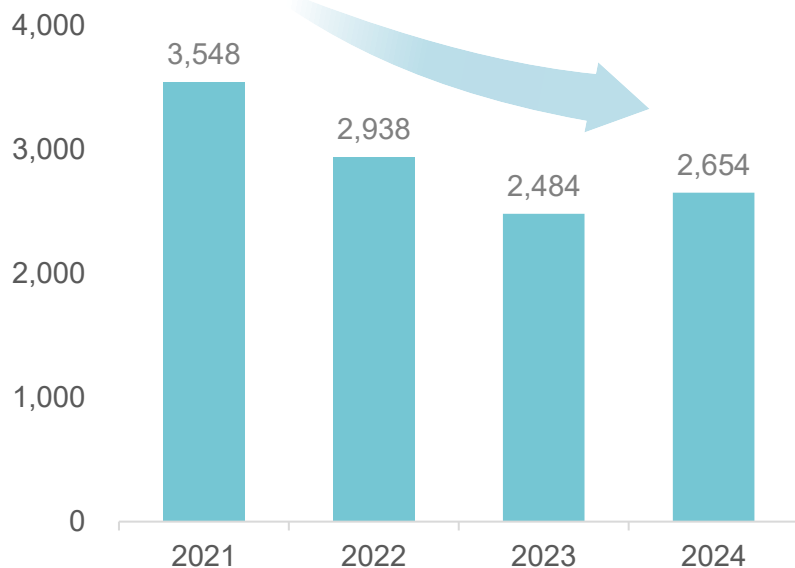
備註: 1. 用電密集度 = MWh / 合併營收 (新台幣千元)
2. 溫室氣體排放密集度 = 二氧化碳當量公噸 / 合併營收 (新台幣千元)

ESG 實施成果：環境保護 – 水資源管理

- 2024 年，環球晶圓總耗水量降至 2,654 百萬公升，較 2021 年減少 25%，顯示集團持續致力於節水與營運效率。
- 同時，回收水量提升至 7,268 百萬公升，創下四年新高，反映各據點在水資源再利用基礎設施與循環系統方面的改善。值得注意的是，回收水量超過總耗水量，顯示多次循環再利用與有效的節水績效。
- 台灣據點的水回收率自 2023 年低點 45.2% 大幅回升至 2024 年的 59.3%；海外據點也持續改善，達到 20.0%。展現集團強化區域水回收系統，以及跨據點水資源回收再利用的管理經驗共享。

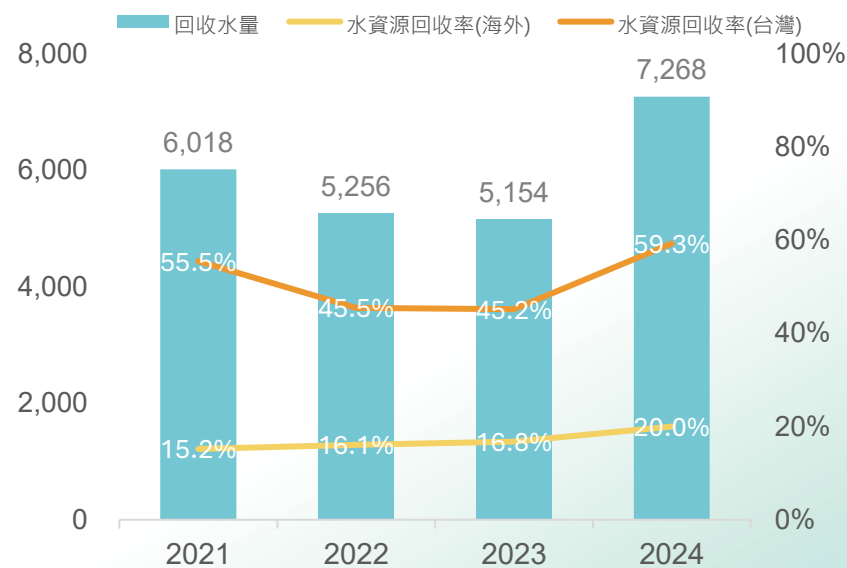
耗水量, 2021-2024

(百萬公升)



水資源回收, 2021-2024

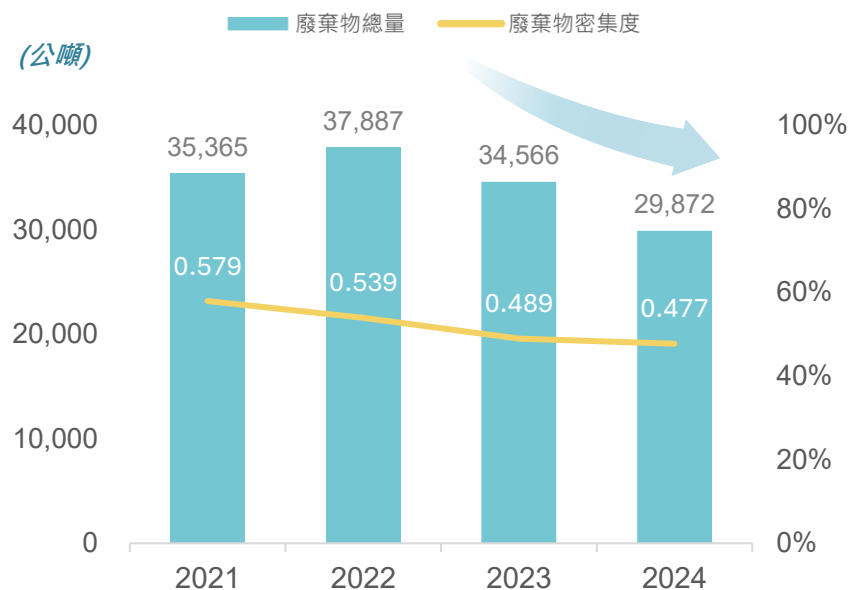
(百萬公升)



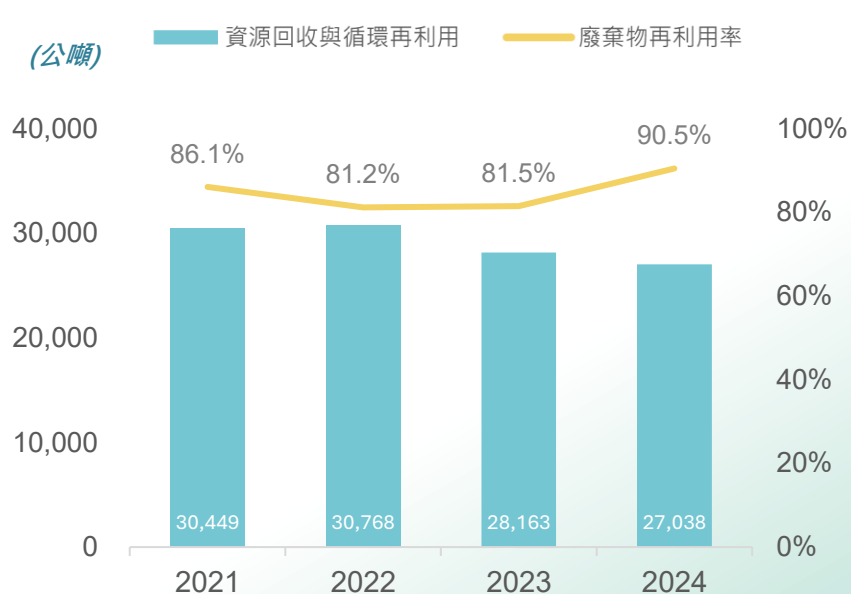
ESG 實施成果：環境保護 – 廢棄物

- 在持續擴產與海外生產活動增加的情況下，環球晶圓強化廢棄物管理策略，聚焦源頭減量與循環利用，其成果顯示，2024 年產生的廢棄物總量降至 29,872 公噸，較 2022 年高峰減少逾 8,000 公噸，兩年間減幅達 21%。
- 廢棄物密集度亦由 2021 年的 0.579 下降至 0.477，顯示製程效率與材料使用效益均有顯著提升。
- 在循環利用方面，集團於 2024 年完成 27,038 公噸的廢棄物回收與循環再利用，使廢棄物再利用率提升至 90.5%，創下近年新高，較前一年增加近 9 個百分點。此成長歸功於分類改善、製程優化以及各廠區實施廢棄物回收措施的成果。

廢棄物總量, 2021-2024



廢棄物回收, 2021-2024



備註: 1. 廢棄物密集度 = 公噸 / 合併營收 (新台幣千元)

ESG 實施成果：保護生物多樣性

- 生物多樣性喪失與生態系統崩潰已被世界經濟論壇《2025 全球風險報告》列為全球主要風險之一。作為回應，環球晶圓投入資源推動多項生物多樣性專案。

環球晶圓生物多樣性專案



濕地生態系統

環球晶圓攜手苗栗塭內社區與國立聯合大學，在竹南沿海濕地推動生物多樣性保育，**透過資料平台、AI 環境教育及智慧農業**，共同促進生態系復育與在地永續。此專案聚焦紅樹林與紫斑蝶等重要棲地，支持生態復育與地方永續



蜜蜂棲地

環球晶圓義大利子公司 SPA 在其諾瓦拉與美拉諾據點**設置蜂箱**，以支持蜜蜂築巢、覓食與繁殖，同時**種植多樣化植被**，打造對授粉生物友善的棲地，提升生物多樣性並促進原生物種復育



海洋廢棄物

環球晶圓義大利子公司 SPA 透過為期兩年的合作，參與 Ogyre 發起的 **#OceanChallenge** 行動，每年投入 **20,000 歐元**，以支持減少海洋塑膠污染、**促進當地漁民社群參與**，推動生物多樣性復育

ESG 實施成果：公司治理

- 為鞏固治理基礎並保持技術領先，環球晶圓持續強化治理架構，同時積極擴展專利布局。
- 透過多元化的專利策略，環球晶圓在第一至第三代半導體技術領域強化競爭優勢，目前**累積超過 2,500 件有效專利**，並**連續四年進入本國專利申請百大排行**。
- 在公司治理表現方面，環球晶圓屢獲肯定，包括榮獲《天下永續公民獎》、連續七年進入公司治理評鑑上櫃組前5%、持續入選富時永續指數系列 (FTSE4Good Index Series)，並連續三年入榜「外資精選台灣 100 強」。

公司治理獎項



天下永續公民獎



公司治理評鑑連續七年進入上櫃組前5%



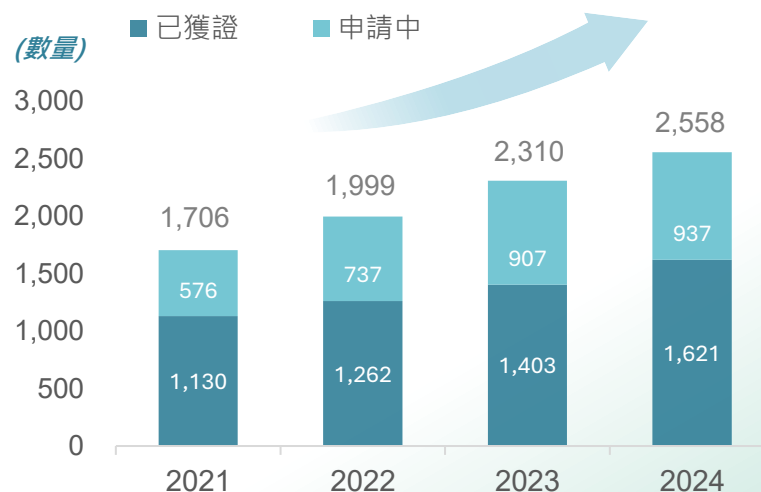
富時永續指數系列



三度入榜「外資精選台灣 100 強」



有效專利 (集團總數, 2021-2024)

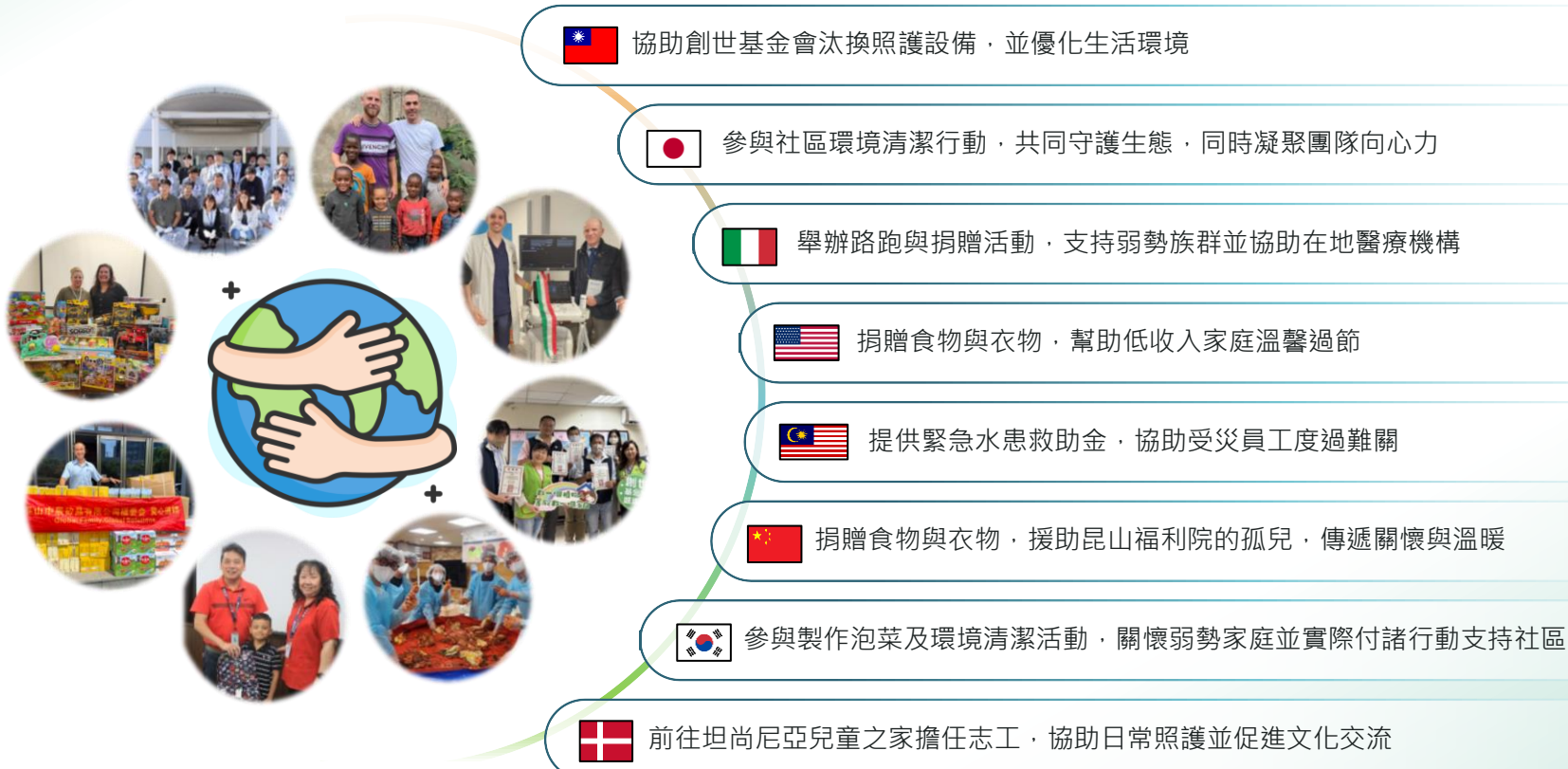


連續四年進入本國專利申請百大排行

ESG 實施成果：全球社會公益

- 2024 年，環球晶圓將關懷的足跡拓展至全球，在台灣、日本、義大利、美國、南韓、中國、丹麥與馬來西亞等地推展多元公益行動，透過捐款、志工服務與緊急救援，積極支持在地社區。
- 環球晶圓致力於世界各地傳遞愛與責任，實踐為社會創造共享價值的使命。

2024 年全球公益行動



05

Q&A